

加工対象

金属／樹脂

（板厚：数μm程度 穴径：Φ50~100μm）

特徴

- ・ 基板上の積層された金属と樹脂を同時に加工することが可能
- ・ パルスエネルギーのモニター制御により安定化が実現
- ・ 高速で安定した加工が可能
- ・ 最小のパターンでは微細な加工が可能
- ・ ガーバーデータやDXFデータで加工対応が可能



短パルスCO2レーザー 3月より加工承ります



当社従来比 2倍の加工速度 を実現
薄板の金属や樹脂への穴あけ加工
が可能です

穴あけ 微細加工

ML605GTW6(-H)5500

加工機

テーブル速度	8 3 3 mm/s (50m/min)
テーブルサイズ	X 7 4 5 mm Y 5 7 5 mm
テーブルストローク	X 6 2 0 mm Y 5 6 0 mm
位置決め精度	± 5 μm
繰り返し精度	± 2 μm
吸引チャック機能	搭載
マスクチェンジャー	Φ 0.9 ~ 8.0 (19種類)
縮小率	M 2 0
最小～最大パターン寸法	Φ 0.04 ~ 0.4

発振器

波長	9.3 μm
出力	540 W
最大周波数	10 kHz
パルス幅	1 ~ 15 μs ・ 16 ~ 100 μs (調整可能)
発振モード	トップハット
搭載基数	2基
位置決め精度	± 15 μm
繰り返し精度	± 10 μm
スキャンエリア	45 mm × 45 mm

ガルバノ